【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年1月29日(2009.1.29)

【公開番号】特開2006-108234(P2006-108234A)
【公開日】平成18年4月20日(2006.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2006-016
【出願番号】特願2004-290133(P2004-290133)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/60　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/3205　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/52　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/60　３０１Ｐ
Ｈ０１Ｌ　21/88　Ｔ

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月9日(2008.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
従来、リレー等の大きな駆動電流（例えば１０アンペア以上）が要求される半導体デバイスや、ＬＤＭＯＳ等のパワーデバイスと、これらのデバイス上に形成された厚いＣｕ電極とを備える半導体装置（ＩＣチップ）がある（例えば、特許文献１、２参照）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
これは、Ｃｕ電極層２の表面に酸化膜７３が形成されている状態で、Ｃｕ電極層２の表面を有機樹脂膜８１で覆うと、Ｃｕ電極層２と有機樹脂膜８１との密着性が低下してしまうので、これを抑制するためである。
【特許文献１】特開２００３－１５２０１５号公報
【特許文献２】特開平１０－４１２９８号公報